



TG-NSP25

熱伝導パテ

RoHS Compliant

製品特長

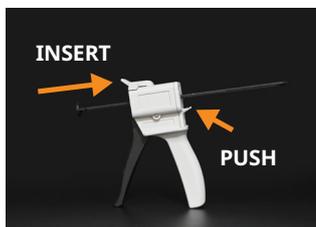
- ・ ノンシリコンの材質
- ・ グリースより長い信頼性
- ・ シートより低い熱抵抗
- ・ ディスペンサーと合わせて作業出来

応用範囲

Best for high-speed or middle-power chipset

Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

取扱説明書



① Push the latch and insert the stick.



② Put the tube in and twist.



③ Close the cover.

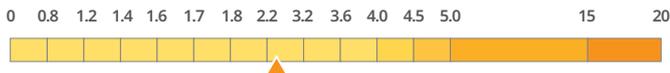


④ Take off the plug.

(The putty in the picture does not represent the actual product.)

製品物性

熱伝導率 : 2.6 W/m·K



製品物性	単位	TG-NSP25	公差	試験基準
熱伝導率	W/m·K	2.6	±10%	ASTM D5470 Modified
色	-	Gray	-	-
粘性	Pa·s	5000	-	Brookfield Viscometer
密度	g/cm ³	2.6	-	ASTM D792
低分子シロキサン (D3-10)	ppm	0	-	GC/MS
体積抵抗	Ohm·m	10 ¹⁴	-	ASTM D257
使用温度範囲	°C	-50~+150	-	-
標準梱包	-	シリンジ包装 / バケツ	-	-

T-Global Technology 株式会社

Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

T +81-3-6863-6387 E japan@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version20
20250124



注意：本技術からのデータ情報は T-Global からの研究や検査により出てきた最も良い結果です。データ上の数は典型的な数字で、各バッチ製品を検査することではありません。もしスペックが変更されたら、別に通知することとをしません。剥離紙と保護フィルムは製品の効率に影響を与えられません、特別な要望がなければ、T-Global の評価を基準にします。各種の可能な使用条件が弊社のコントロールできる範囲を超えることで、弊社は提出させていただきましたアドバイスは何の保証や責任が生じることがありません。ですので、お客様は製品を試しながら、弊社の製品が各種の条件で応用できるかどうかご確認ください。本製品を売買する時には何か特定のところで応用できることを保証することがありません。但し、本製品が T-Global とお互いに確認した Invoice、お見積りやご注文に基づき、基準的な品質を提供させていただきます。我々は使用者がどのように本技術からのデータ情報を使うことに責任を持ちません。一方、本技術から生み出されたデータ情報は説明内容や製品に関する用途、未来特許衝突、工芸製造や製品の使用についてのアドバイスなどが含まれておりません。